



美格智能 SRM817模组

5G Advanced Ready LGA封装模组

美格智能SRM817系列模组是一款专为IoT/eMBB应用而设计的5G Advanced Ready Sub-6GHz模组,基于高通技术公司的骁龙®X72 5G调制解调器及射频系统设计,符合最新的3GPP Release 17标准及特性,支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)方式并向下兼容4G网络,可覆盖全球主流运营商网络。SRM817系列模组可支持5G NR下行CA,支持Sub-6GHz TDD/FDD 3CC载波聚合,可支持最大200MHz带宽,有效提高5G上下行传输速率。

该模组采用LGA封装,尺寸为56.0x49.0x2.95mm,采用四核A55处理器,主频最高可到2.2GHz,拥有更强的处理能力,并可提供丰富的功能接口方便用户进行外设扩展,支持3组高速PCIe、2组USXGMII、USB3.1、SDIO、SPI、多路UART、ADC、GPIO等接口,内部预留eSIM支持,可支持最新一代Wi-Fi 7解决方案以及10Gb的以太网能力,可为FWA/eMBB/工业路由等产品带来更加灵活的方案选择和更有竞争力的性价比。

支持OpenWRT操作系统,同时支持OpenCPU,更具灵活性,大大简化5G整机类产品开发流程,将强有力赋能FWA、eMBB、汽车、工业物联网和5G企业专网等垂直行业及相关产品。

主要优势:

- 符合3GPP Release 17标准
- 支持Sub-6GHz TDD/FDD 3CC载波聚合,最大200MHz带宽
- 多组PCIe、USXGMII高速接口,软AP方案更灵活
- 支持OpenWRT操作系统,同时支持OpenCPU



5G NR



SA&NSA



LGA封装



多组PCIe/USXGMII



OpenWRT



-40°C-85°C

MeiG Smart SRM817模组

5G Advanced Ready LGA封装模组

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性:

- 封装: LGA 封装
- 尺寸: 56.0×49.0×2.95mm
- 重量: <15g

模组速率:

- 5G NR SA:
- 4Gbps DL/900Mbps UL
- LTE:
- 2Gbps DL/200Mbps UL

驱动&工具:

- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 图形化升级工具, 多系统下日志工具
- USB升级, FOTA升级

网络协议:

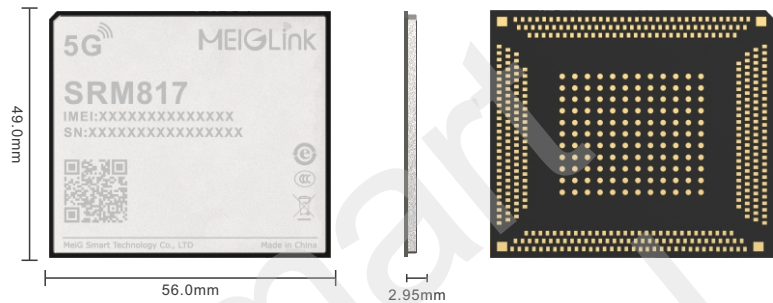
- RNDIS/NDIS/IPv4/IPv6/TCP/UDP

模组接口:

- USB3.1 × 1
- PCIe Gen3.0 × 3
- USXGMII × 2
- SDIO3.0 x1
- I2C x 1, I2S x 1, SPI x 1, GPIOs
- USIM × 2
- 7个天线接口:
4G/5G x6
GNSS x1

认证信息:

- CCC*/SRRC*/CTA*/CE*/FCC*



发射功率:

- Class 2 (26dBm±1.5dB) for N40/41/N77/N78
- Class 3 (23dBm±1.5dB) for 5G others & LTE

环境温湿度特性:

- 正常工作温度: -30°C to +75°C
- 扩展工作温度: -40°C to +85°C
- 存储温度: -40°C to +90°C
- 湿度: 5%~95%

SRM817系列频段信息:

-EA: Region: Europe, Australia, Japan, Korea, Southeast Asia

5G SA&NSA:

FDD:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N71/N75/N76

TDD:N38/N40/N41/N77/N78

LTE:

FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32

TDD:B38/B40/B41/B42/B43/B71

WCDMA:

B1/B5/B8

-NA: Region: America

5G SA&NSA:

FDD:N2/N5/N7(30)/N12/N13/N14/N25/N26/N29/N66/N71

TDD:N38/N41/N48/N77/N78

LTE:

FDD:B2/B4/B5/B7(30)/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71

TDD:B38/B41/B42/B43/B48

WCDMA:

B2/B4/B5

备注: * 研发中

